

智原科技公佈 2025 年第三季財務報告

第三季合併營收新台幣 32.4 億元，季減 28%，年增 12%，EPS NT\$0.58

智原獲 4 奈米 AI ASIC 新案，2.5D 及 3D 先進封裝成功打入北美客戶

2025 年第三季合併財務報表摘要

- 營業收入為新台幣 32.4 億元
- 毛利率為 33.2%
- 歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 1.5 億元
- 基本每股盈餘為新台幣 0.58 元

台灣·新竹 – 2025 年 10 月 28 日 – 智原科技 (TWSE: 3035)，ASIC 設計服務暨矽智財(IP)研發銷售領導廠商，今日公佈 2025 年第三季合併財務報表，合併營收新台幣 32.4 億元，季減 28%，年增 12%，毛利率為 33.2%，歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 1.5 億元，基本每股盈餘為新台幣 0.58 元。

回顧第三季，合併營收為新台幣 32.4 億元，雖較上季減少 28%，但仍較去年同期增長 12%。從產品結構來看，IP 營收表現亮眼達新台幣 4.1 億元，季增幅度達 43%，惟較去年同期歷史高點微幅減少 7%。NRE 收入攀升至新台幣 4.9 億元，雖較上季增加 19%，然因客戶調整立案時程以致增幅未達預期，較去年同期則減少 24%；量產營收較上季減少 39%，為新台幣 23.3 億元，但仍較去年同期增加 30%。值得一提的是，公司持續深化先進製程及先進封裝兩大引擎並取得突破性進展，不僅成功拿下 4 奈米 AI ASIC 新案，彰顯國際客戶對智原在先進製程開發及 AI 領域設計能力的雙重認可，同時，公司更憑藉著先進封裝量產成功的實績，獲得來自北美客戶的 2.5D 及 3D 先進封裝新案，顯示智原區域性市場多元化策略取得成效。在晶圓代工策略方面，智原在先進製程上採取多源代工策略 (Multiple Foundry Strategy) 並與四大國際晶圓代工夥伴建立策略合作關係，目前已完整掌握各合作伙伴之製程設計套件 (Process Design Kit, PDK)，並正式啟用設計平台承接客戶專案，此項佈局不僅滿足客戶分散地緣風險的需求，更在近期半導體供應鏈重組浪潮中凸顯戰略價值。

展望未來，儘管第四季整體營收預期將迎來短期回檔，全年營收仍可望締造歷史新高。面對國際市場變化，智原的多源代工策略提供了供應鏈韌性，以降低單一供應商風險及地緣政治影響；同時，透過調配不同代工夥伴的製程優勢與產能配置，可以提升先進封裝與異質整合的靈活性，實現最佳技術搭配，更重要的是能滿足政策合規與在地化生產要求。中長期而言，隨著先進製程及先進封裝設計案的累積，加上全球化製造與封裝網絡佈局，將有助於公司提升整體解決方案的附加價值，鞏固市場競爭優勢。

營運成果

營運成果

(單位: 百萬新台幣)	2025 年第三季	2025 年第二季	增(減) %	2024 年第三季	增(減) %
營業收入淨額	3,236	4,512	(28.3)	2,884	12.2
營業毛利	1,075	1,091	(1.5)	1,338	(19.7)
營業費用	(1,035)	(1,027)	0.8	(1,029)	0.6
營業利益	40	64	(38.1)	309	(87.2)
營業外收入及支出	173	(19)	(1001.8)	44	296.5
本期淨利(歸屬母公司業主)	152	26	487.3	264	(42.5)
基本每股盈餘 (元)	0.58	0.10		1.01	

財務報告

營業成本、營業費用與營業外收入及支出

(單位: 百萬新台幣)	2025 年第三季	2025 年第二季	增(減) %	2024 年第三季	增(減) %
營業收入淨額	3,236	4,512	(28.3)	2,884	12.2
營業成本	(2,161)	(3,421)	(36.8)	(1,546)	39.7
營業毛利	1,075	1,091	(1.5)	1,338	(19.7)
毛利率 (%)	33.2%	24.2%		46.4%	
營業費用	(1,035)	(1,027)	0.8	(1,029)	0.6
營業利益	40	64	(38.1)	309	(87.2)
營業利潤率 (%)	1.3%	1.4%		10.7%	
營業外收入及支出	173	(19)	(1001.8)	44	296.5

流動資產

(單位: 百萬新台幣)	2025.09.30	2025.06.30	2024.09.30
現金及約當現金	7,820	8,372	8,319
應收票據及帳款淨額	1,434	944	1,236
應收帳款週轉天數	22	15	47
存貨淨額	1,425	1,947	842
存貨週轉天數	30	29	64
流動資產合計	11,558	12,016	10,901

負債

(單位: 百萬新台幣)	2025.09.30	2025.06.30	2024.09.30
流動負債合計	5,141	5,625	3,888
應付票據及帳款	1,835	1,439	1,412
其他	3,306	4,186	2,476
非流動負債合計	611	681	1,019
負債總計	5,752	6,306	4,907
負債/權益比	43.9%	49.8%	36.3%

營收分析

委託設計營收（應用別）

應用	2025 年第三季	2025 年第二季	2024 年第三季
通訊網路	7.5%	7.7%	22.4%
行業用	27.9%	49.2%	62.7%
多媒體/消費性電子/ 電腦週邊	4.0%	2.4%	3.6%
HPC & AI	51.3%	31.6%	3.1%
IoT	9.3%	9.1%	8.2%

委託設計營收（製程技術別）

技術	2025 年第三季	2025 年第二季	2024 年第三季
≥0.25um	0.7%	0.7%	0.5%
0.11um~0.18um	2.7%	4.6%	2.0%
55nm~90nm	1.6%	3.8%	8.2%
40nm	31.6%	10.7%	11.9%
28nm	12.8%	28.5%	41.3%
≤14nm	50.6%	51.7%	36.1%

量產營收（應用別）

應用	2025 年第三季	2025 年第二季	2024 年第三季
通訊網路	8.6%	3.6%	10.3%
行業用	13.9%	9.7%	28.0%
多媒體/消費性電子/ 電腦週邊	8.1%	4.0%	6.4%
HPC & AI	43.5%	60.3%	2.1%
IoT	25.9%	22.4%	53.2%

量產營收（製程技術別）

技術	2025 年第三季	2025 年第二季	2024 年第三季
≥0.25um	0.4%	0.3%	0.6%
0.11um~0.18um	6.9%	3.8%	7.5%
55nm~90nm	26.9%	19.6%	58.3%
40nm	16.0%	12.8%	21.4%
28nm	6.5%	3.3%	12.2%
≤14nm	43.3%	60.2%	-

總營收（產品別）

產品	2025 年第三季	2025 年第二季	2024 年第三季
量產	72.0%	84.5%	62.0%
委託設計服務	15.2%	9.1%	22.5%
矽智財	12.8%	6.4%	15.5%

Contact

曾雯如
財務長兼發言人
+886-3-5787888

盧昭儀
投資人關係
+886-3-5787888 ext. 84588
ir@faraday-tech.com

關於智原

智原科技（Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035）以提供造福人類、支持永續發展的晶片為使命，持續發展完整的 ASIC 解決方案，包含 2.5D/3D 先進封裝、Arm Neoverse CSS 設計、FPGA-Go-ASIC 與晶片實體設計服務。同時，智原擁有豐富的矽智財資料庫，涵蓋 I/O、Cell Library、Memory Compiler、ARM-compliant CPUs、LPDDR4/4X、DDR4/3、MIPI D-PHY、V-by-One、USB 3.1/2.0、10/100/Giga Ethernet、SATA3/2、PCIe Gen4/3、可程式設計高速 SerDes，及 PCIe Gen4/3 等數百個週邊訊號 IP。更多資訊，請瀏覽智原科技網站：www.faraday-tech.com 或 [LinkedIn](#) 專頁。